

第 10 回 LSI IP デザイン・アワード応募要項（企業）

1．趣旨

半導体設計資産（LSI IP:LSI Intellectual Property）の公募、評価・審査、登録公開、助成金・賞金授与の仕組みを通して、システム LSI の実現に不可欠な IP の創造・開発を促進するとともに、エレクトロニクス産業の飛躍的發展に貢献する。

2．主催・共催

主催：LSI IP デザイン・アワード運営委員会
共催：財団法人電気・電子情報学術振興財団

3．対象

システム LSI を実現するためのハード設計資産およびソフト設計資産を対象とする。ハード設計資産は LSI の回路を意味し、1) アルゴリズム、2) ソフト VC (Virtual Component)、3) ハード VC の三つからなる。ここでアルゴリズムとは、LSI 回路を設計することを目的に書かれた動作記述を言う。また、ソフト VC とは RTL (Register Transfer Level) 記述を、ハード VC とはハードマクロコアを意味する。ソフト設計資産はミドルウェアなどの組み込み用途向けのソフトウェアである。

募集は自由部門と課題部門に分かれる。自由部門では、応募者自身が自由にテーマを決める。課題部門は LSI IP デザイン・アワード運営委員会がテーマを指定する。

ここで言う IP とは、システム LSI の中に組み込むことができる再利用可能なハードウェア、およびシステム LSI 上で動作するソフトウェアを意味する。

注) EDA ツールは賞の対象から除外する。ただし、メモリーやデータ・パスなどの LSI 回路を生成するジェネレータおよびコンパイラは対象とする。

4．課題部門テーマ

画像圧縮技術
エラー訂正技術
暗号技術
CAM (Content Addressable memory)
再利用を容易にする高速バス技術
低電力技術

5．審査基準

- 1) 新規性：アイデアの良さを評価
 - 2) 有用性：市場にとって、どれだけ必要とされているかを評価
 - 3) 実用性：効率、性能、機能などの視点から、どれだけ実用性があるかを評価
 - 4) 品質：チェック・シート等を基に、どの程度の品質・検証レベルかを評価
 - 5) 完成度：再利用しやすいか、提供物などがどれだけ揃っているかを評価
 - 6) 親和性：他社の設計環境でどれだけスムーズに IP を実装できるかを評価
- 注) 賞を決定するとき、上記評価指標は 1) ~ 6) の順に優先する。したがって、1) が最も重要な指標になる。

6．提出書類

いずれの応募者も次に示す書類を電子データで下記宛に提出しなければならない。データの

形式は PDF データを原則とする。サイズはすべて A4。1) LSI IP デザイン・アワード応募書類表紙、2) 特徴の説明を一つの PDF ファイルにまとめる。書送付方法は郵送だけでなく、E-mail も可。

1) LSI IP デザイン・アワード応募書類表紙

指定された項目を記入し、提出する。項目および記入例を示す PDF データを LSI IP デザイン・アワードのトップページ (<http://techon.nikkeibp.co.jp/award/>) からダウンロードすることができる。

2) 特徴の説明書

特徴の説明は 5 ページ以内とする。説明には次に示す内容を含める。特徴、分野、機能、性能、新規性、使用したツール、動作環境、説明に必要な図版、参考文献など。

3) チェック・シート

LSI IP デザイン・アワード運営委員会が用意したチェック・シートに、必要事項を記入したもの。チェック・シートは LSI IP デザイン・アワードのトップページからダウンロードすることができる。(URL は <http://techon.nikkeibp.co.jp/award/>)

4) 仕様書・スペック

必要に応じて添付する。形式は自由だが、サイズは A4。

提出先

〒107-0052 東京都港区 2-17-22
赤坂ツインタワー東館 17F
(株)テクノアソシエーツ内
株式会社日経 BP 電子・機械局 IP 開発部
LSI IP デザイン・アワード事務局
宮崎 信行宛
TEL : 03-5545-1720 FAX : 03-5545-1721
E-mail : nobumiya@nikkeibp.co.jp

7. 締め切り

事前登録 2007 年 12 月 21 日 (金)

論文提出の前に事前登録をお願いします。

- ・論文タイトル(仮のタイトルでも結構です)
- ・著者
- ・連絡先 氏名、住所、電話番号、Email アドレス(代表者で結構です)
上記内容を(株)テクノアソシエーツ宮崎(nobumiya@nikkeibp.co.jp)まで、郵送または Fax、Email でお知らせ下さい。

論文提出 2008 年 1 月 25 日 (金) 必着

8. 表彰

応募した者の中から審査委員会が優れていると認めた者に IP 賞を贈り、表彰する。受賞者には、財団法人電気・電子情報学術振興財団より助成金 100 万円(最高)を授与する。

受賞者は、LSI IP デザイン・アワード運営委員会が設ける表彰式の中で IP の概要を発表しなければならない。また受賞者には、本人の合意のもとに LSI IP デザイン・アワードのホームページ上で受賞論文を開示していただく。

9. 購入検討の扱い

LSI IP デザイン・アワード運営委員会では、協賛企業が応募 IP の購入を検討するかどうかの希望をとる。購入検討の希望がある場合、応募者へ連絡して協賛企業との相談の機会を提供する。ただし、それ以降の交渉に関しては当事者同士の話し合いとする。委員会の活動は当事者同士を紹介だけである。LSI IP デザイン・アワード運営委員会は、この活動に伴い、何ら義務を負うことはない。

10. 権利化について

LSI IP デザイン・アワードは、応募された IP を権利化するための団体ではない。応募者が技術を権利化したい場合には、以下の団体へ連絡することを薦める。

特許：特許庁

〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関 3-4-3
TEL：03-3581-1101
URL：<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

レイアウト：(財)工業所有権協力センター

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 4-26-5
TEL：03-5600-2601
URL：<http://www.ipcc.or.jp/>

著作権：ソフトウェア情報センター

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 4F
TEL：03-3437-3071
URL：<http://www.softic.or.jp>

11. 応募資格

この賞は企業または個人を対象とする。国籍は問わない。

12. LSI IP デザイン・アワード運営委員会

委員長	田中昭二	財団法人国際超電導産業技術研究センター副理事長 兼超電導工学研究所所長
副委員長	浅田邦博	東京大学教授 大規模集積システム設計教育研究センターセンター長
委員	川上博平	松下電器産業株式会社上席理事
委員	福岡雅夫	NEC エレクトロニクス株式会社執行役員
委員	佐藤哮一郎	株式会社東芝セミコンダクター社首席技監
委員	伊藤達	株式会社ルネサス テクノロジ代表取締役会長兼 CEO
委員	村上丈示	富士通株式会社常務理事電子デバイス事業本部副本部長
委員	疋田純一	ローム株式会社常務取締役
委員	武田浩	セイコーエプソン株式会社半導体事業部副事業部長
委員	後藤潔	日本政策投資銀行情報通信部長
委員	大輝精一	株式会社日経 BP 代表取締役社長

(2007 年 5 月現在)

13 . 協賛・後援

協賛：松下電器産業株式会社
NEC エレクトロニクス株式会社
株式会社東芝
株式会社ルネサステクノロジ
富士通株式会社
ローム株式会社
セイコーエプソン株式会社
株式会社メイテック
日本政策投資銀行
株式会社日経 BP

後援：東京大学大規模集積システム設計教育研究センター
半導体産業研究所
半導体理工学研究センター
電子情報通信学会
情報処理学会

(2007 年 5 月現在)

14 . 問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区 2-17-22
赤坂ツインタワー東館 17F
(株)テクノアソシエーツ内
株式会社日経 BP 電子・機械局 IP 開発部
LSI IP デザイン・アワード事務局
宮崎 信行 宛
TEL : 03-5545-1720 FAX : 03-5545-1721
E-mail : nobumiya@nikkeibp.co.jp

【応募に際してのご注意】

- ・ご応募いただいた資料は、LSI IP デザイン・アワードの審査に利用致します。
- ・応募資料については、日経 BP 社がお寄せいただいた応募内容を含めたすべての応募情報を取りまとめ、審査を担当する協賛各社にお渡し致します。
- ・ご登録・ご応募いただいた住所やE-Mailアドレスなどは、株式会社日経BPからの事務連絡にのみに使わせていただきます。

以上